

2021年度(2022年3月期) 第3四半期決算概要について



Brightening the Future
Since 1946

2021年度 第3四半期決算概要（連結）

| | |
|-------------|----|
| 決算概況 | 2 |
| プラスチックパッケージ | 6 |
| メタルパッケージ | 8 |
| 部門別売上高 | 10 |

2021年度 通期の見通し（連結）

| | |
|----------------|----|
| 業績予想の修正（1/27付） | 11 |
| 売上高・損益 | 12 |

2021年度 設備投資額・減価償却費・研究開発費

| | |
|----------------|----|
| 配当予想の修正（1/27付） | 15 |
|----------------|----|

決算概況

（単位：億円）

| | 2020年度 3 Q累計 | 2021年度 3 Q累計 | 前年同期比 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|
| | | | | 増減率 |
| 売上高 | 1,355 | 2,008 | +653 | 48% |
| 営業利益 (営業利益率) | 149 (11%) | 525 (26%) | +376 | 253% |
| 経常利益 (経常利益率) | 161 (12%) | 548 (27%) | +387 | 240% |
| 純利益※ (純利益率※) | 109 (8%) | 379 (19%) | +269 | 246% |

※ 親会社株主に帰属する四半期純利益

| | | |
|-------------|--------|---------|
| 1株当たり四半期純利益 | 80.97円 | 280.24円 |
|-------------|--------|---------|

◎2021年度の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用

売上高：

- 半導体業界は、社会・経済におけるデジタル化の急速な進展等を背景に、パソコンやサーバーをはじめ幅広い分野において需要が大きく拡大し、自動車市場向け等において半導体の需給逼迫が顕在化するなど、旺盛な需要環境が継続。

当社グループにおいては、フリップチップタイプパッケージ、リードフレーム、セラミック静電チャックなどの売上が大きく増加し、前年同期比48%増と大幅な増収。

損 益：

- 旺盛な需要を背景とする各製品の売上増加に伴う収益性の向上や、為替相場において円安基調が継続したことなどにより、前年同期比で大幅な増益。

▶ **売上高、各利益とも過去最高となりました。**

セグメント別売上高・経常利益

(単位：億円)

| セグメント | | 2020年度 3Q累計 | | 2021年度 3Q累計 | | 前年同期比 増減率 (%) | 2020年度 | |
|------------|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|--------|
| 売上高 ※1 | | | 構成比(%) | | 構成比(%) | | | 構成比(%) |
| | プラスチックパッケージ | 823 | (61) | 1,268 | (63) | 54 | 1,133 | (60) |
| | メタルパッケージ | 476 | (35) | 673 | (34) | 41 | 664 | (35) |
| | その他 | 57 | (4) | 67 | (3) | 19 | 83 | (5) |
| 合計 | 1,355 | (100) | 2,008 | (100) | 48 | 1,881 | (100) | |
| 経常利益 ※2 | | | 利益率(%) | | 利益率(%) | | | 利益率(%) |
| | プラスチックパッケージ | 104 | (13) | 385 | (30) | 271 | 170 | (15) |
| | メタルパッケージ | 57 | (12) | 158 | (23) | 178 | 91 | (14) |
| | その他/調整額 | 1 | | 6 | | | 4 | |
| 合計 | 161 | (12) | 548 | (27) | 240 | 265 | (14) | |

※1 外部顧客への売上高

※2 セグメント間取引調整前の経常利益

参考情報

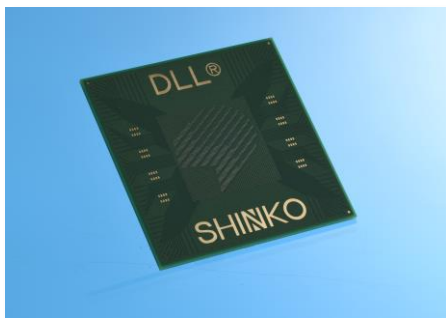
（単位：億円）

| | 2020年度 3 Q | 2021年度 3 Q | 2020年度 |
|--------|------------|------------|--------|
| 総 資 産 | 2,248 | 2,918 | 2,410 |
| 純 資 産 | 1,454 | 1,868 | 1,534 |
| 自己資本比率 | 65% | 64% | 64% |

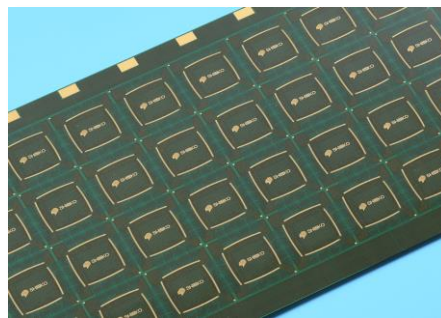
| | | | |
|-------------|------|------|------|
| 設備投資額 ※ | 260 | 459 | 301 |
| 減価償却費 ※ | 117 | 202 | 174 |
| 研究開発費 | 22 | 26 | 30 |
| 為替レート(1米ドル) | 104円 | 110円 | 105円 |

※ 無形固定資産を除く

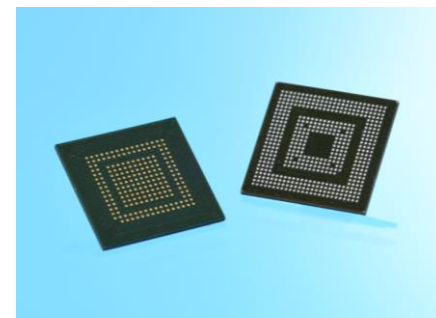
プラスチックパッケージ



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチックBGA基板



IC組立

【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

プラスチックパッケージ

(単位：億円)

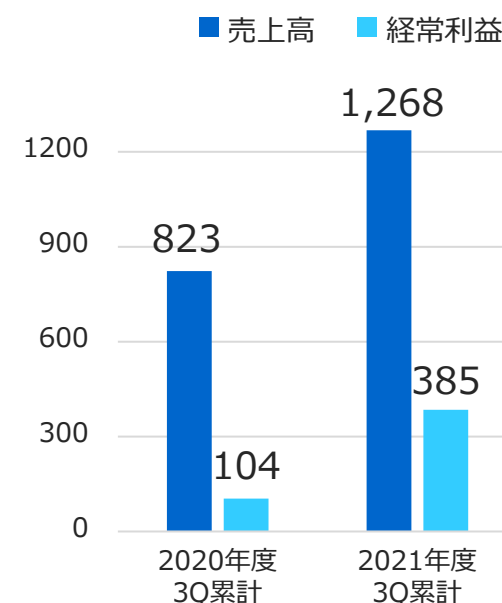
| | 2020年度3Q累計 | 2021年度3Q累計 | 前年同期比 | |
|-----------|------------|-------------|-------|------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 売上高（構成比） | 823 (61%) | 1,268 (63%) | +445 | 54% |
| 経常利益（利益率） | 104 (13%) | 385 (30%) | +281 | 271% |

<売上高>

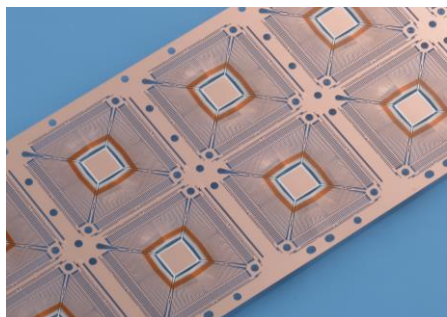
- フリップチップタイプパッケージは、パソコン、サーバー向けの需要拡大により売上が大幅に増加
- IC組立は、ハイエンドスマートフォン向けに受注が大きく増加
- プラスチックBGA基板は、先端メモリーや自動車向けの受注が拡大

<損益>

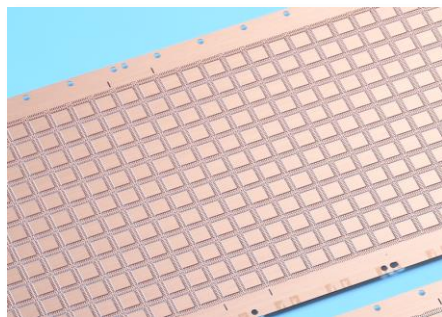
- フリップチップタイプパッケージの売上が高付加価値製品をはじめ大きく増加し、為替相場において円安基調が継続したことなどにより、大幅増益



メタルパッケージ



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム
(QFNタイプ)



セラミック静電チャック



ガラス端子



ヒートスプレッダー

【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、民生機器、半導体製造装置、通信機器 他

メタルパッケージ

（単位：億円）

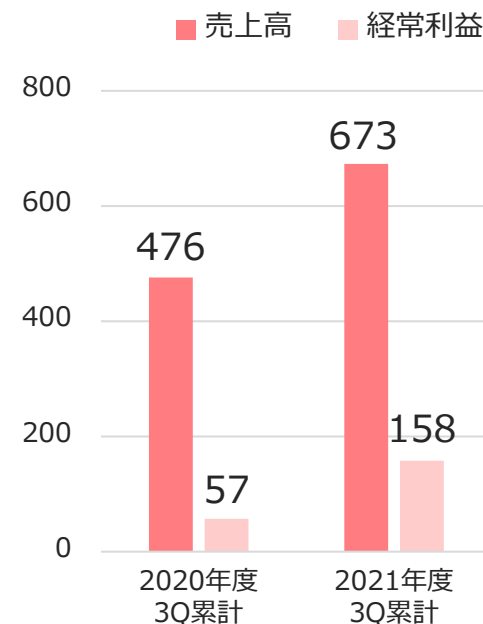
| | 2020年度 3 Q 累計 | 2021年度 3 Q 累計 | 前年同期比 | |
|-----------|---------------|---------------|-------|------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 売上高（構成比） | 476 (35%) | 673 (34%) | +197 | 41% |
| 経常利益（利益率） | 57 (12%) | 158 (23%) | +101 | 178% |

<売上高>

- リードフレームは、自動車市場向けが好調に推移したことに加え、幅広い用途において需要が増加したことを背景に大幅な増収
- セラミック静電チャックは、引き続き半導体製造装置市場における旺盛な需要に支えられ売上が大きく増加
- ガラス端子は、光学機器向けの受注が増加
- CPU向けヒートスプレッダーは、増収

<損益>

- リードフレーム、セラミック静電チャックの増収効果、為替相場において円安基調が継続したことなどにより、大幅増益



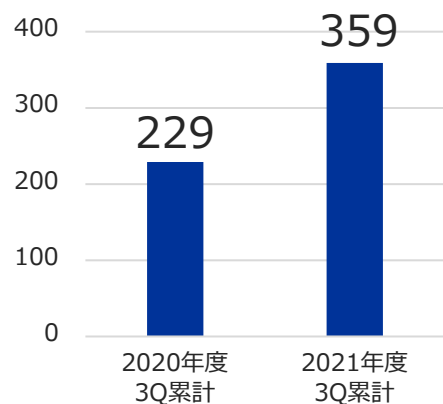
部門別売上高

（単位：億円）

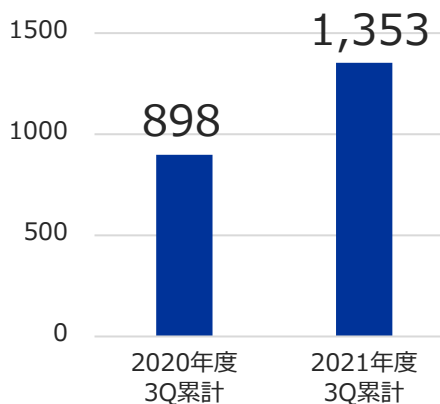
| 部 門 | 2020年度 3 Q累計 | 2021年度 3 Q累計 | 前年同期比 | | 2020年度 |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|-----|----------------|
| | | | | 増減率 | |
| ICリードフレーム | 229 (17%) | 359 (18%) | +130 | 57% | 334 (18%) |
| ICパッケージ | 898 (66%) | 1,353 (67%) | +454 | 51% | 1,231 (65%) |
| 気密部品 | 226 (17%) | 296 (15%) | +70 | 31% | 314 (17%) |

※（ ）は構成比

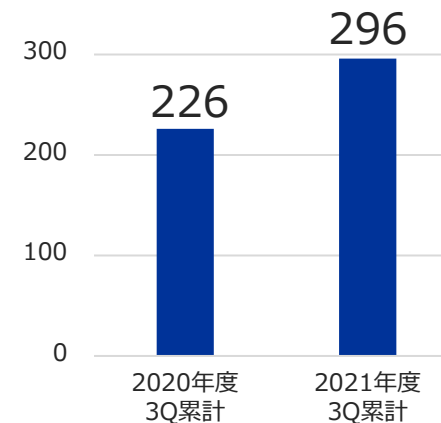
ICリードフレーム部門売上高



ICパッケージ部門売上高



気密部品部門売上高



通期業績予想の修正（2022年1月27日付）

（単位：億円）

| | 2021年度通期 | | | |
|------------|-----------------|----------------|-----|-----|
| | 前回予想 (10/26) | 今回予想 (1/27) | 増減額 | 増減比 |
| 売上高 | 2,642 | 2,700 | 58 | 2% |
| 営業利益 | 594 | 680 | 86 | 14% |
| 経常利益 | 614 | 700 | 86 | 14% |
| 純利益※ | 424 | 490 | 66 | 16% |
| 1株当たり当期純利益 | 313.86円 | 362.72円 | — | — |

※親会社株主に帰属する当純利益

修正理由（要旨）

- 半導体市場は、社会・経済におけるデジタル化の急速な進展等による半導体需要の拡大が継続
- 第3四半期において、フリップチップタイプパッケージはパソコンおよびサーバー向けの需要が想定を上回り、リードフレームは自動車向け等の受注がさらに増加。また、為替相場が想定に比べ円安基調で推移したことに加え、売上増加が収益性に寄与するとともに生産性が向上したことなどにより、特に収益面において想定を上回って進捗
- このような状況をふまえ、2021年10月26日に発表した通期連結業績予想数値を修正
- 通期業績予想の前提となる第4四半期の為替レートを1米ドル=108円から110円に変更

売上高・損益

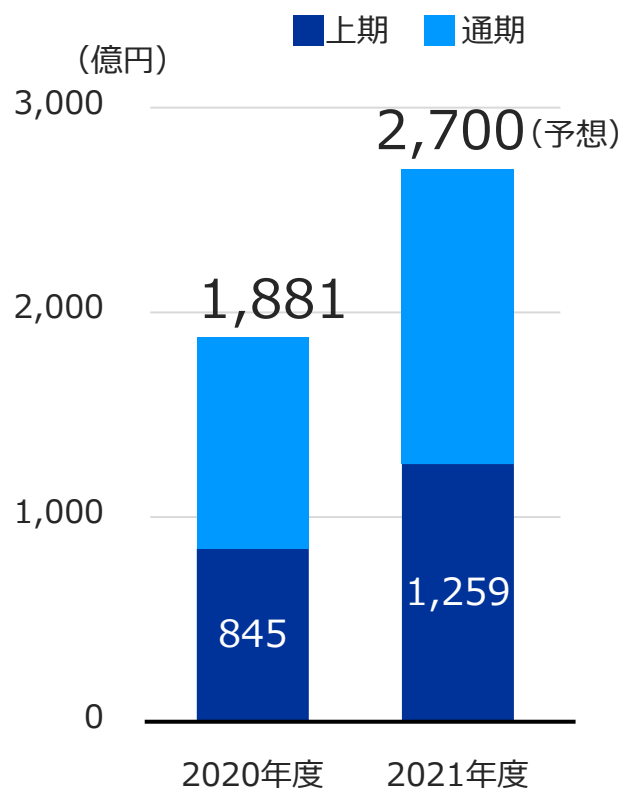
(単位：億円)

| | 2020年度 (実績) | | | 2021年度 (上期実績・下期予想) | | | 前期比 (上段：増減金額、下段：増減比率) | | |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | 上期 | 下期 | 通期 | 上期 | 下期 | 通期 | 上期 | 下期 | 通期 |
| 売上高 | 845 | 1,036 | 1,881 | 1,259 | 1,441 | 2,700 | 415 (49%) | 405 (39%) | 819 (44%) |
| 営業利益 (営業利益率) | 72 (9%) | 161 (16%) | 233 (12%) | 301 (24%) | 379 (26%) | 680 (25%) | 228 (315%) | 219 (136%) | 447 (191%) |
| 経常利益 (経常利益率) | 83 (10%) | 182 (18%) | 265 (14%) | 316 (25%) | 384 (27%) | 700 (26%) | 232 (278%) | 203 (112%) | 435 (164%) |
| 純利益※ (当期純利益率※) | 56 (7%) | 124 (12%) | 180 (10%) | 217 (17%) | 273 (19%) | 490 (18%) | 161 (290%) | 148 (119%) | 310 (172%) |
| 為替レート | 105円/\$ | | | 第3四半期累計期間 実績 110円/\$ | 第4四半期 想定 110円/\$ | | | | |

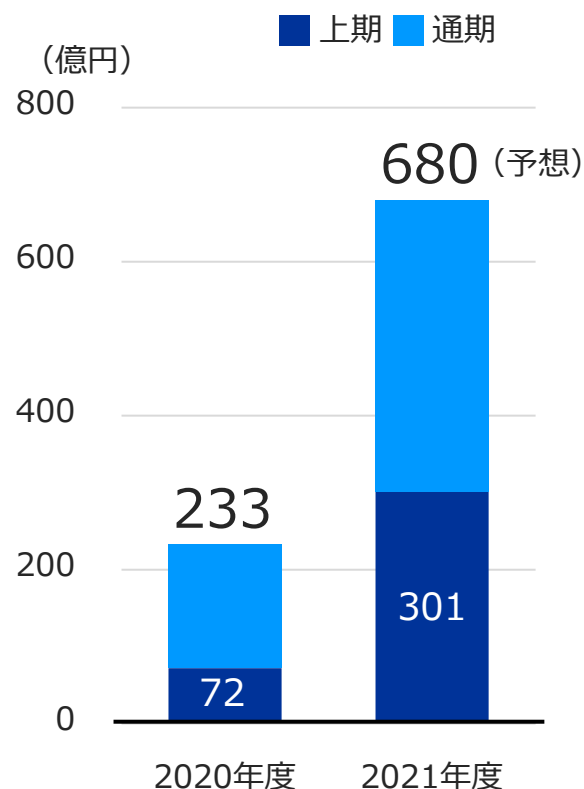
※ 親会社株主に帰属する当期純利益

2021年度 通期の見通し (連結)

売上高

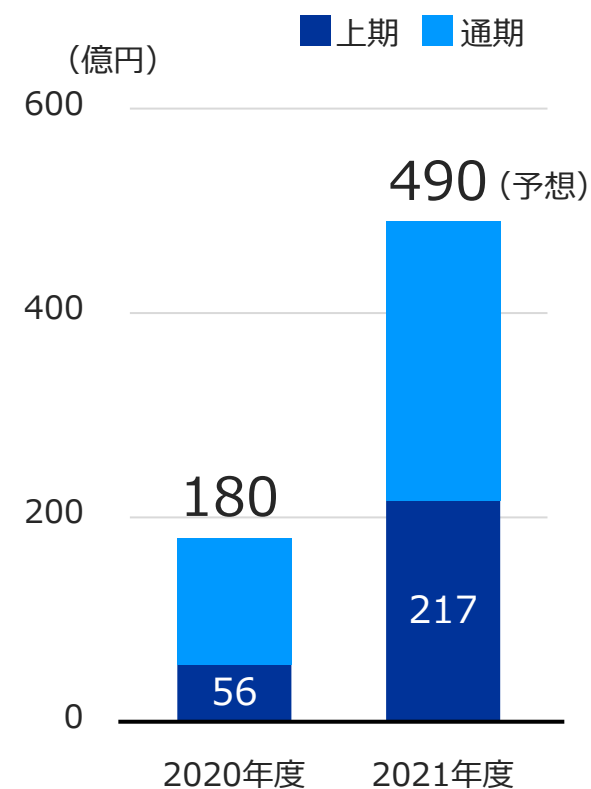


営業利益

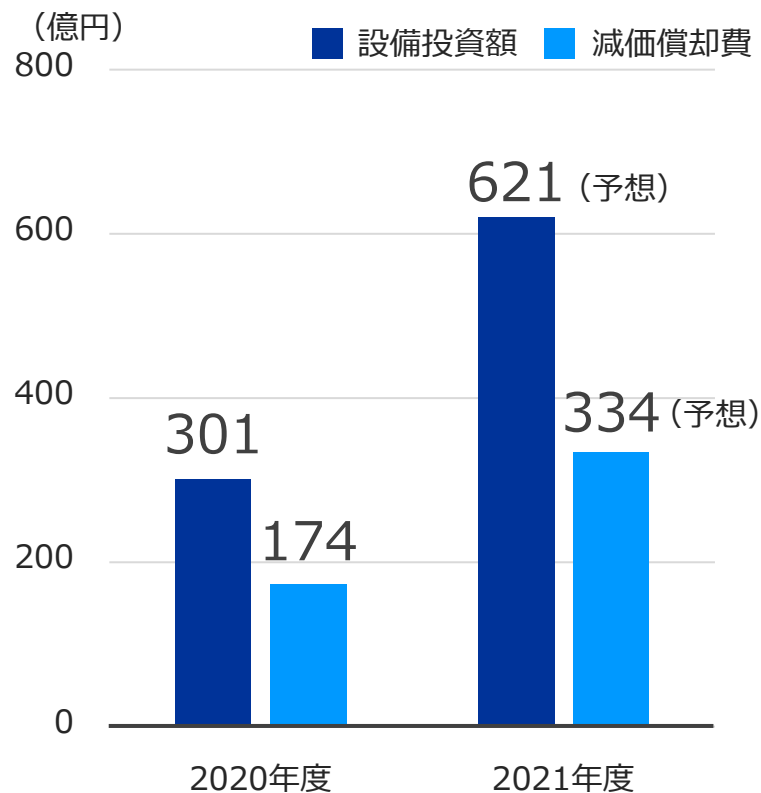


純利益※

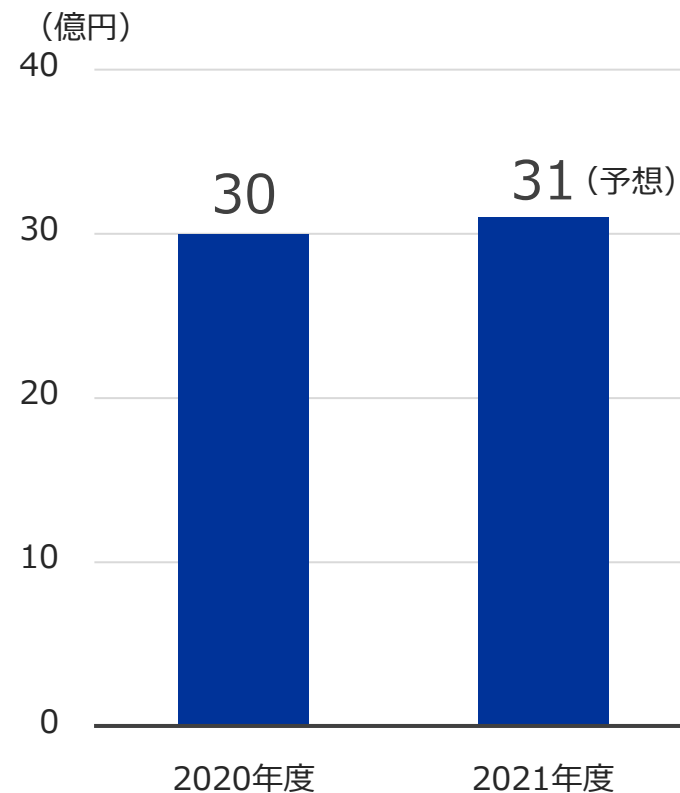
※親会社株主に帰属する当期純利益



設備投資額・減価償却費



研究開発費



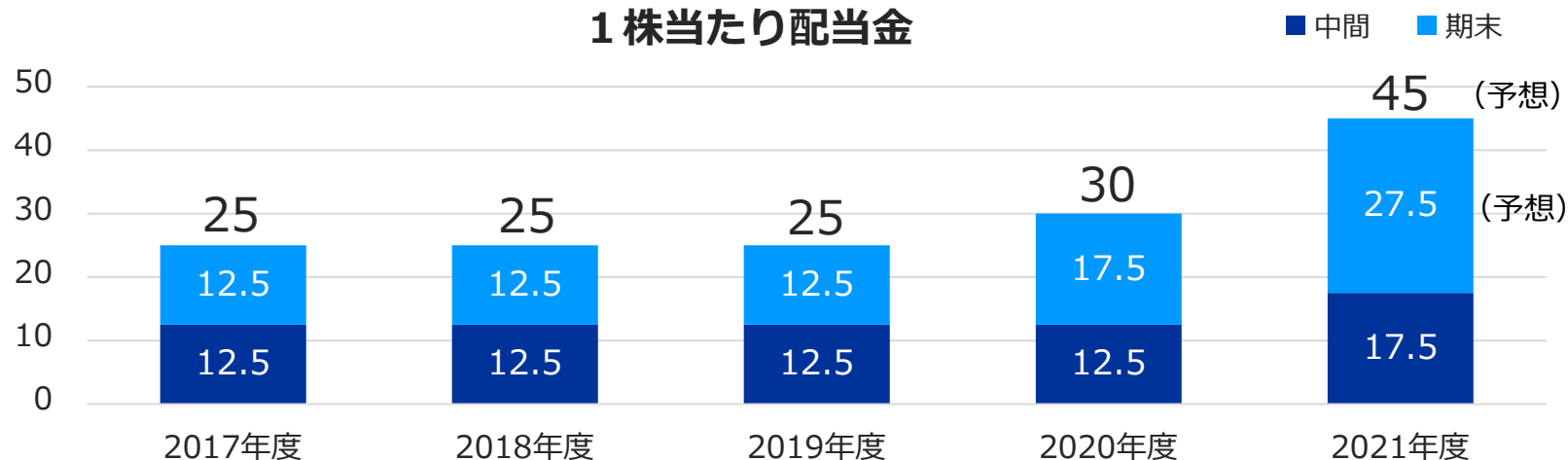
修正内容

| | 1株当たり配当金 | | |
|---------------------|----------|--------|--------|
| | 第2四半期末 | 期 末 | 年 間 |
| 前回予想（2021年4月27日公表） | 17円50銭 | 17円50銭 | 35円00銭 |
| 今回修正予想 | | 27円50銭 | 45円00銭 |
| 当期実績 | 17円50銭 | | |
| （ご参考）前期実績（2021年3月期） | 12円50銭 | 17円50銭 | 30円00銭 |

修正理由（要旨）

配当に関する基本方針のもと、2022年3月期通期連結業績予想および先般発表した成長市場向けの設備投資計画等をふまえ、期末配当予想を修正

1株当たり配当金



本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信または四半期報告書を参照していただきますようお願いいたします。